

# ClasSiC™ CMP Slurries for SiC Polishing

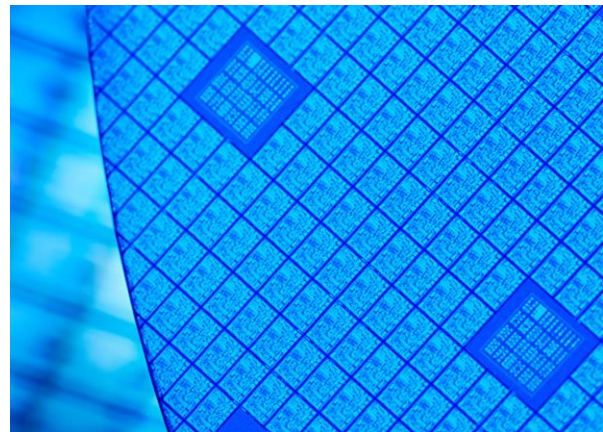


仏国サンゴバン社のSiC用CMPスラリーClasSiC™は、LEDおよびパワーデバイスの製造に使用されるSiCウエハの化学機械的平坦化用に特別に配合された高精度スラリーです。サンゴバン社のナノアルミナ研磨材(CMP)を使用したClasSiC™CMPスラリーは、研磨レートと平坦化性能を大幅に向上させ、SiCウエハ上で優れた表面仕上げを実現します。

ClasSiC™スラリーは、最適な酸化剤、厳密に設計、管理されたナノ粒子、極めて低いレベルの表面欠落(スクラッチ、潜傷等)を促進する促進剤で配合されています。これにより非常に高品位な表面仕上げ、低いTTV、LTV、およびワープを提供します。

ClasSiC™スラリーは分散安定性と酸化安定性を有しており、管理と洗浄が容易です。

- 高い研磨レート、 $>2 \mu / \text{hr}$
- 優れた表面仕上げ、標準的には $<2.5 \text{ \AA}$
- 非常に低いTTV、 $<3 \mu$  with  $\Delta < 1 \mu$
- 非常に低いLTV、 $<1.5 \mu$  with  $\Delta < 0.5 \mu$
- 非常に低い反り、 $<20 \mu$  with  $\Delta < 1 \mu$
- スクラッチおよび表面欠陥が極めて少ない
- Si終端面のエピレディ面を提供
- 優れた安定性、洗浄性、酸化安定性



## ClasSiC™ 100

- ナノアルミナCMPスラリー
- SiC研磨レート  $2 \mu / \text{hr}$  (Si面) &  $5 \mu / \text{hr}$  (C面)
- 低TTV、LTVおよびワープ、 $\Delta < 1 \mu$
- pH = 2.0~2.5で使用
- 1年以上の有効期間

販売代理店:ケメットジャパン株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブウエスト21階

TEL:043-21-9911 FAX:043-213-9932 INFO:info@kemet.jp